

# OSP有机保护膜配方转让

产品名称	OSP有机保护膜配方转让
公司名称	苏州三润化工科技有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	
公司地址	吴江江陵东路8号
联系电话	18136094710

## 产品详情

铜抗氧化剂是适用于双面板,多层板和挠性印制电路板的水溶性预焊剂,用于取代传统的PCB表面处理,该产品可在铜表面及孔内提供一层均匀致密的有机防护涂层(OSP),保持铜表面的整平性及防止铜面被氧化,并在铜面经多次回流焊的热烘烤后,仍具有优良的可焊接能力。该技术具有工序简单,成本低廉,安全可靠、符合欧美环保要求的特点,铜抗氧化剂的成膜机理是依靠与金属铜表面产生络合反应,形成有机物-金键,成膜性能远远优于市面上仅适用于单面板和普通双面板的第三代及第四代抗氧化剂,能耐受数次(>3次)的高温(270℃)热冲击后,仍能保有优良的铜面焊锡性;可兼容适用于一般免洗、低残留物的助焊剂(锡膏),并符合电路板装配作业(PCBs Assembly)免洗制程的需求。

## 四、操作条件

PH 值3.0 - 4.0

浓度80 - 130%

温度35 - 450C

浸泡时间50 - 70 秒

膜厚0.20 - 0.40um

加热器铁氟龙、钛、石英

槽体材质PP 或PVC

## 五、产品特性

颜色：蓝色透明液体

比重（25℃）： $1.02 \pm 0.1$

pH值： $3.1 \pm 0.3$  pH